



SPRS TECHNOLOGIES

P/N: STBP142-5R0-A349

Thin Film Planar Filters

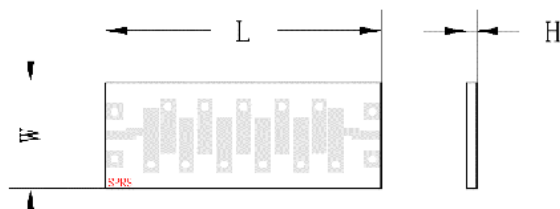
## 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

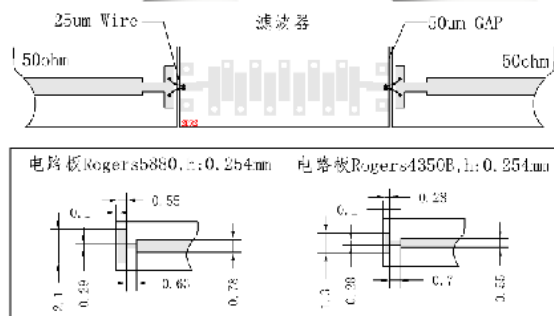
技术要求,  $T_A = 25^\circ\text{C}$

| 参数                | 最小   | 典型   | 最大   | 单位               |
|-------------------|------|------|------|------------------|
| 中心频率              |      | 14.2 |      | GHz              |
| 工作频率              | 11.7 |      | 16.7 | GHz              |
| 中心损耗              |      | 1.2  | 1.7  | dB               |
| 带内波动              |      | 0.9  | 1.0  | dB               |
| 回波损耗              | 12   | 15   |      | dB               |
| 带外抑制@DC-9.4GHz    | 35   | 40   |      | dBc              |
| 带外抑制@18.0-36.0GHz | 35   | 40   |      | dBc              |
| 承受功率              |      |      | 33   | dBm              |
| 工作温度              | -55  |      | +85  | $^\circ\text{C}$ |
| 储存温度              | -55  |      | +125 | $^\circ\text{C}$ |

外形图:  $L: 7.0$ ,  $W: 3.0$ ,  $H: 0.254$ , 端口居中



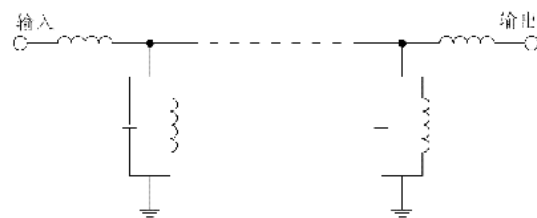
## 推荐装配图:



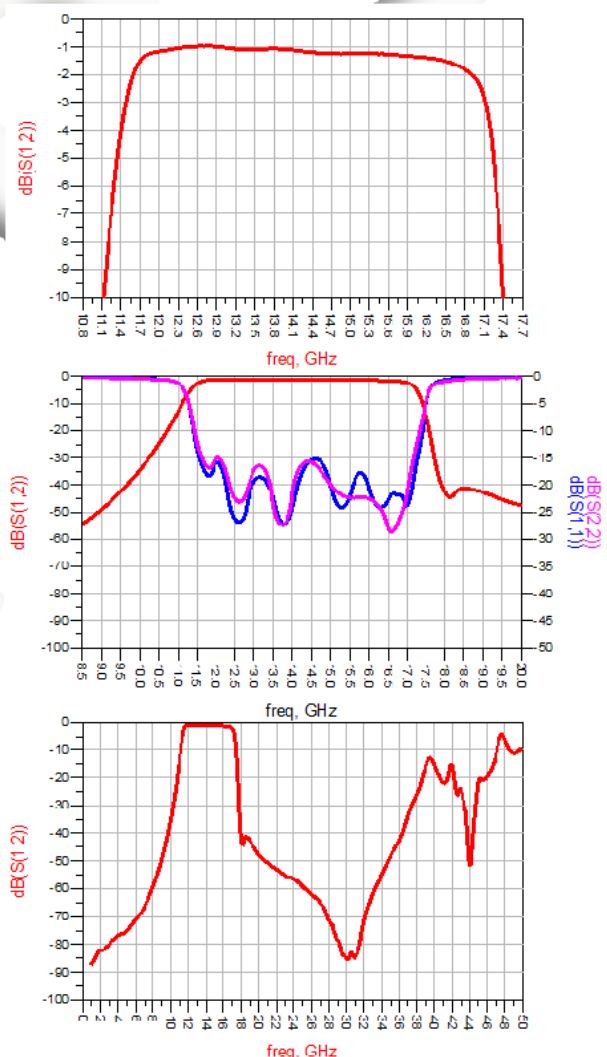
## 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**1.75mm**，芯片端口可互换；
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ )，载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ；
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配；

## 原理图



## 典型曲线, $T_A = 25^\circ\text{C}$



Tel: 18349127722

Fax: +86 28-80566718

Email: pengxiaojun@cdsprs.com

注: 本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。

官网 [www.com-mw.com](http://www.com-mw.com)

商城 [www.dianzibuy.com](http://www.dianzibuy.com)

电话 15608095669

邮箱 [sales@com-mw.com](mailto:sales@com-mw.com)

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。